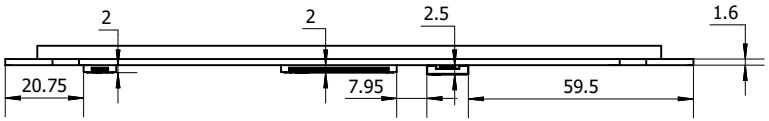

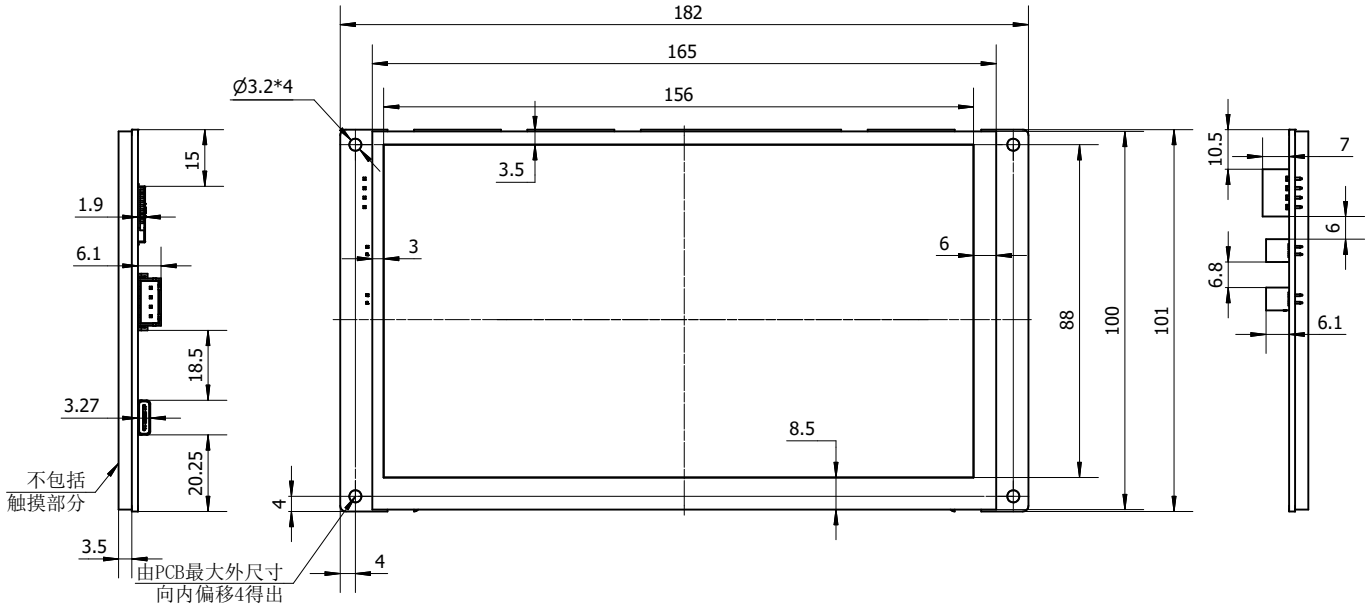

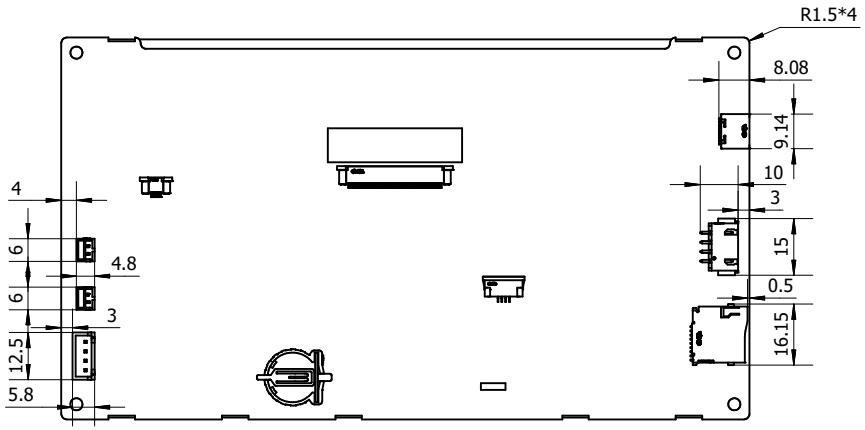

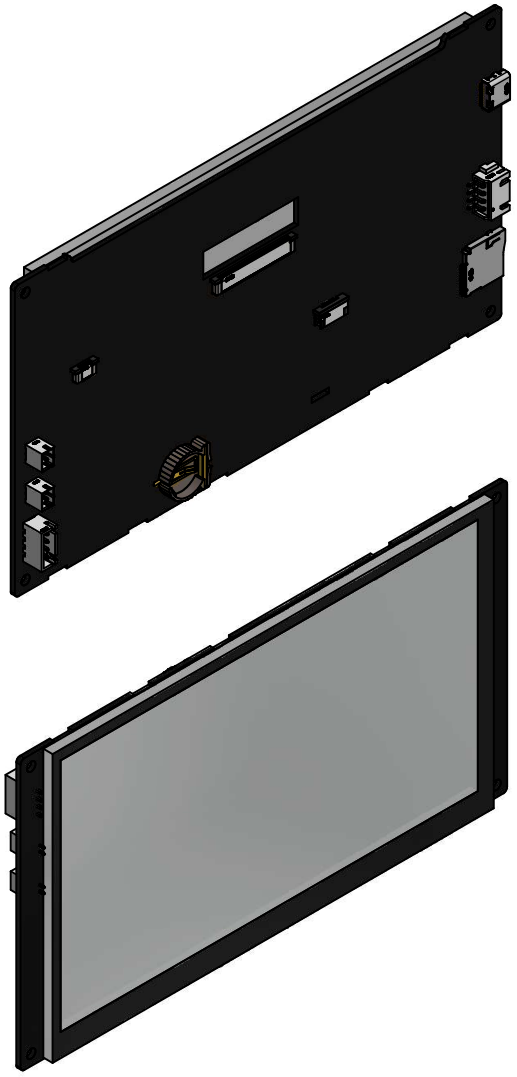

									三易半导体科技
									S70系列
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段标记	重量(Kg)	比例
设计	赵奥琰	2025/12/26	标准化						1 : 1
审核									模型
工艺			批准						